(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. April 2002 (18.04.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/31563 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 6/26, 6/43, 6/06, 6/36

G02B 6/42,

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(22) I am and the American American

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/03551

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. Oktober 2000 (10.10.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HIMMLER, Andreas [DE/DE]; Pohlweg 34, 33098 Paderborn (DE).

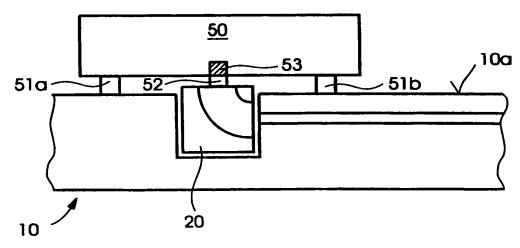
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: DEFLECTED COUPLING OUT OF LIGHT GUIDES WHICH ARE EMBEDDED IN A PRINTED CIRCUIT BOARD
- (54) Bezeichnung: UMLENKENDE AUSKOPPLUNG IN EINER LEITERPLATTE EINGEBETTETER LICHTLEITER



- (57) Abstract: The invention relates to an arrangement providing a coupling to a coupling surface of a light guide (13) which is located inside a printed circuit board (10). A deflecting coupler (20) projects the image of the coupling surface (15) into a plane that is parallel to the surface of the printed circuit board.
- (57) Zusammenfassung: Anordnung zur Kopplung an eine Koppelfläche eines Lichtleiters (13), der sich im Innern einer Leiterplatte (10) befindet, wobei ein Umlenkkoppler (20) das Bild der Koppelfläche (15) in eine Ebene parallel zu der Oberfläche der Leiterplatte abbildet.

02/3156

Umlenkende Auskopplung in einer Leiterplatte eingebetteter Lichtleiter

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft die Kopplung in einer Leiterplatte 5 eingebetteter Lichtleiter an auf der Oberfläche der Leiterplatte befindliche Bauelemente.

Stand der Technik

Für zukünftige Informations- und Kommunikationsgeräte sind Leiterplatten vorgesehen, die neben elektrischen auch optische Leiter enthalten. Eine zentrale Aufgabe in dieser Technologie ist die Kopplung der elektischen mit den optischen Leitern.

Für die elektrischen Verbindungen einer Leiterplatte ist eine entwickelte Technologie bekannt, bei der auf der Oberfläche der Leiterplatte elektrische Komponenten mit hoher Genauigkeit von Millimeterbruchteilen positioniert und dann festgelötet werden.

Für die Herstellung von optischen Leitern in einer Leiterplatte sind eine Anzahl von Verfahren bekannt.

Bei dem Übergang der optischen in die elektrischen Leiter sind elektro-optische Wandler verwendet. Diese müssen jedoch sehr genau an die Enden der Lichtleiter positioniert werden, damit eine effiziente und zuverlässige Kopplung gewährleistet ist. Dabei ist nicht nur die hohe Genauig-

keit der Position an sich das Problem; vielmehr liegen die Lichtleiter im Innern der Leiterplatten.

Ein Vorschlag für einen Zugang zu in einer Leiterplatte eingebetteten Lichtleitern führt diese in nicht allzugroßem Biegeradius an die Oberfläche, wo die optischen Fasern dann einzeln an einen Verbinder angeschlossen werden müssen. Der Verbinder sorgt über mechanische Präzisionsflächen oder -Öffnungen für die notwendige mechanische Positioniergenauigkeit. Die prozesstechnische Behandlung der Lichtleiter ist jedoch recht aufwendig; insbesondere müssen die einzelnen Fasern einzeln an die Steckverbinder angeschlossen werden. Auch müssen die Enden der Fasern während der Herstellung und Bearbeitung der Leiterplatte gesondert und aufwendig geschüzt werden.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine wesentlich vereinfachte Auskopplung von in einer Leiterplatte eingebetteten Lichtleitern an elektro-optischen Bauelemente anzugeben.

Darstellung der Erfindung

Die Erfindung benutzt optische Umlenkeinheiten, die die Enden der Lichtleiter von einer Ebene senkrecht zu der Oberfläche in die Ebene der Oberfläche der Leiterplatte umsetzen. Hierzu werden die Lichtleiter zunächst vollständig in die Leiterplatte eingebettet und erst später in einem Arbeitsgang freigelegt und dabei von überflüssigen Enden abgetrennt. Eine unkritisch zu positionierende Umlenkeinheit wird sodann an die freigelegten Enden ange-

3 .

fügt und lenkt das aus den Enden austretende Licht auf die Oberfläche um.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, welche in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen die Erfindung an Hand eines Ausführungsbeispiels erläutert.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

Es zeigen

- Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Leiterplatte mit

 einem Lichtleiter, welche Ausgangsbasis für die

 Anwendung der Erfindung ist,
 - Fig. 2 wie Fig. 1 nach Anwendung des ersten Fertigungsschritts,
 - Fig. 3 wie Fig. 1 nach dem zweiten Fertigungschritt,
- 15 Fig. 4 einen alternativen Umlenkkoppler,
 - Fig. 5 eine fertiggestellte Anordnung.

Beschreibung einer Ausführungsform der Erfindung

Fig. 1 zeigt einen nicht maßstabsgerechten Querschnitt durch eine Leiterplatte 10 mit isolierenden, elektrischen und optischen Lagen. Die isolierenden und elektischen Lagen sind der Übersichtlichkeit halber nicht getrennt dargestellt, sondern lediglich zu den Lagen 11a und 11b zusammengefaßt. In einer optischen Lage 12 befindet sich ein optischer Leiter 13, wobei der gezeigte Querschnitt

so gewählt ist, daß die Schnittebene senkrecht auf der Oberfläche 10a der Leiterplatte und ferner durch die Mittelachse des optischen Leiters 13 geht, der beispielsweise einen runden Querschnitt hat, der in Fig.1 als pers spektivisches Oval angedeutet ist. Um als Lichtleiter dienen zu können, weist die Faser einen Kern 13b mit hohem Brechungsindex und einen Mantel 13a mit dagegen kleinerm Brechungsindex auf. Ob diese als Stufen- oder Gradientenindex-Lichtleiter ausgeführt sind, ist dabei ohne 10 Bedeutung. Es ist auch ohne Bedeutung für die Erfindung, wie eine Leiterplatte mit solchen Lichtleitern hergestellt wird. Eine, wenn auch möglicherweise nicht male, Herstellungsform besteht darin, in die untere Lage 11b Gräben zu fräsen, in diese bekannte Fasern aus Polyacrylat oder Glas einzulegen, eine Einbettungsmasse aufzutragen und durch diese die obere Lage 11a mit der unteren 11b zu verkleben. Denn die Aufgabe der Erfindung besteht ja darin, eine Kopplung an die optischen Wellenleiter anzugeben, wenn diese im Innern einer Leiterplatte durch welches Verfahren auch immer eingebettet sind. Dabei ist zu beachten, daß dieses, wie auch die bislang bekannte, Verfahren zwar durchaus einen sehr gut reproduzierbaren Abstand der Lichtleiter zueinander - in derselben Lage, versteht sich - erreicht, aber durch das Zusam-25 menpressen der Lagen der Abstand der optischen Lage und insbesondere der Achsen der Lichtleiter von der Oberfläche der fertigen Leiterplatte wesentlich weniger gut reproduzierbar ist und insbesondere größer ist als der Durchmesser der Lichtleiter.

Die Erfindung löst die Aufgabe, eine Kopplung an die in der Leiterplatte eingebetteten Lichtleiter zu bewirken.

Hierzu wird in einem ersten Schritt der Herstellung eine Öffnung 14 angelelgt, wie es in Fig. 2 dargestellt ist. Diese Öffnung geht von der Oberfläche 10a aus und ist mindestens so tief, wie der optische Leiter 13 tief in der Leiterplatte ist. Der optische Leiter wird dabei unterbrochen. Die bevorzugte Methode zum Erstellen der Öffnung 14 ist ein Fräsvorgang, der senkrecht zur Ebene der Fig.2 erfolgt. Durch den Fräsvorgang entsteht an dem Übergang von der Öffnung 14 zu dem Lichtleiter 13 eine plane Koppelfläche 15.

Zwar wird durch das Anlegen der Öffnung der Lichtleiter unterbrochen. Dieses erfolgt meist nahe dem Ende des Lichtleiters; der verbleibende Rest ist ohne Bedeutung. Dieser Vorgang entspricht dem Abschneiden eines Kabels bei der Montage in einem Verteiler, bei dem ja auch die überschüssigen Enden abgeschnitten und verworfen werden.

Die Tiefe dieser Öffnung 14 ist, wie bereits erwähnt, so groß, daß der Lichtleiter vollständig durchtrennt wird. Die Breite in der Richtung der Achse des Lichtleiters richtet sich nach der Ausdehnung eines Umlenkkopplers, der im folgenden näher beschrieben ist. Die Breite quer zur Achse des Lichtleiters richtet sich nach der Anzahl der gleichzeitig zu koppelnden Lichtleiter; dies wird gleichfalls weiter unten beschrieben.

In diese öffnung 14 wird ein Umlenkkoppler 20 eingesetzt, wie dies in Fig. 3 angedeutet ist. In Fig. 3 wurden die Proportionen etwas angepaßt, damit klar sichtbar wird, daß der Lichtleiter relativ dünn ist.

Der Umlenkkoppler 20 besteht bevorzugt im wesentlichen aus einem kurzen Stück 22, in Fig. 3 gepunktet dargestellt, eines faseroptischen Bildleiters, der nach dem Stand der Technik aus einer großen Anzahl sehr dünner optischer Fasern besteht, die zu einem Bündel derart zusammengefügt sind, daß die relative Lage der Fasern in dem Bündel gleich bleibt, die Fasern nicht in Längsrichtung koppeln und zudem aneinander fixiert sind. Solche Bildleiter werden unter der Bezeichnung 'image conduit' beispielsweise von der Firma Schott nach Kundenspezifikationen gefertigt. Die Enden sind plan abgeschnitten. Wird auf eines der beiden Enden ein Bild projiziert, dann erscheint eben dieses Bild an dem anderen Ende. In dem in der Erfindung bevorzugt verwendeten Umlenkkoppler 20 beschreibt, wie in Fig. 3 angedeutet, das Fasernbündel einen Winkel von 90°. Damit kann also ein in der Eintrittsebene 23a liegendes Bild in die Austrittsebene 23b umgesetzt werden. Da die optischen Effekte in der Regel umkehrbar sind, ist klar, daß auch umgekehrt Licht in die Austrittsebene 23b eintreten kann und dann aus der Eintrittsebene 23a wieder austritt. Zur Vereinfachung der Beschreibung wird jedoch diese Bezeichnung beibehalten.

Die Faserbündel haben für jede der Faser eine numerische Apertur, die an der Ein- und Austrittsebene unterschiedlich eingestellt sein kann, womit dann auch deren Flächen entsprechend unterschiedlich sind. Auf jeden Fall sollte zur Minimierung der Kopplungsverluste die numerische Apertur des Fasernbündels an der Eintrittsfläche gleich der des Lichtleiters sein. Die Apertur an der Austrittsfläche sollte an die des anzukoppelnden elektro-optischen Wandlers angepaßt sein.

Der Umlenkkoppler 20 wird also in die Öffnung 14 derart eingesetzt, daß die Eintrittsebene 23a plan auf die Koppelfläche 15 des Lichtleiters 13 aufliegt und diesen überragt. Mit anderen Worten, die Eintrittsebene 23a hat 5 eine wesentlich größere Fläche als der Querschnitt des Lichtleiters plus die mechanischen Toleranzen, mit denen die Öffnung relativ zur Achse des Lichtleiters gefräst werden kann. Bevorzugt haben die Fasern in dem Fasernbündel 22 einen Durchmesser unterhalb der Hälfte des Durch-10 messers des Lichtleiters, um geringe Verluste bei der Ankopplung sicherzustellen. Der Zwischenraum zwischen der Eintrittsebene 23a des Umlenkkopplers 22 und der Koppelfläche 15 des Lichtleiters 13 wird durch einen transparenten Füll- und Klebstoff mit geeignetem Brechungsindex ausgefüllt. Die anderen in der Leiterplatte befindlichen Oberflächen des Umlenkkoppler 20 werden bevorzugt gleichfalls durch Kleben befestigt, so daß der Umlenkkoppler in der Leiterplatte fixiert ist. Es sei darauf hingewiesen, daß, da der Querschnitt der Eintrittsfläche wesentlich größer als der Duchmesser des Lichtleiters ist, hierbei keine besondere mechanische Positionierung des Umlenkkopplers erforderlich ist; dieser wird lediglich in die Öffnung 14 eingelassen und während des Aushärtens der Klebstoffe gegen die Koppelfläche 15 gedrückt, um hier die Übergangsverluste klein zu halten. Es ergibt sich damit, daß in den Lichtleiter 13 eingespeistes Licht von dem Umlenkkoppler an die Oberfläche gebracht wird und dort als Lichtpunkt auf der Austrittsfläche 23b erscheint. Dessen Lage in der x-y-Ebene der Leiterplattenoberfläche ist relativ ungenau vorbestimmt, da diese

insbesondere von der Tiefe abhängt, in der sich der Lichtleiter in der Leiterplatte befindet.

In einer Weiterbildung der Erfindung werden mehrere, in der Leiterplatte in Bezug auf die Oberfläche nebeneinander liegende Lichtleiter angekoppelt. Die optischen Wellenleiter können auch übereinander liegen, wenn sie in derselben optischen Lage angeordnet sind und der Herstellungsprozeß geringe vertikale Toleranzen zuläßt. Wie oben dargestellt, kann mit den bekannten Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten mit eingebetteten Lichtleitern ein gut reproduzierbarer Abstand der Achsen der Lichtleiter erreicht werden, dessen Fehler deutlich unterhalb dem optischen Durchmesser der Lichtleiter liegt. Damit haben dann die Austrittspunkte der Lichtleiter nach ihrer Umlenkung auf die Oberfläche gleichfalls untereinander einen gut reproduzierbaren Abstand, wenn auch die Lage dieses Bandes von Punkten in der x-y-Ebene in Bezug auf die auf der Oberfläche angebrachten Leiterbahnen wesentlich stärker variiert.

Anstelle eines Bildleiter-Fasernbündels kann auch ein Hohlspiegel 29 als Umlenkkoppler verwendet werden, wie in Fig. 4 angedeutet. Auch dieser muß jedoch an die Apertur des aus dem Lichtleiter austretenden Lichtbündels angepaßt werden. Dieser Umlenkkoppler ist bevorzugt quaderförmig mit senkrecht aufeinander stehenden Ein- und Austrittsflächen ausgebildet. Die Achse des Hohlspiegels steht senkrecht auf und geht durch die Schnittlinie der Ein- und Austrittsflächen bzw. deren Verlängerungen. Die Achse des Lichtleiters steht senkrecht auf der Eintrittsfläche. Der Hohlspiegel bewirkt damit, daß das den Lichtfläche.

leiter verlassende, an der Eintrittsfläche eintretende, divergierende Lichtbündel gesammelt, umgelenkt und durch die Austrittsebene den Umlenkkoppler verläßt. Da der Hohlspiegel wesentlich größer ausgeführt ist als der Durchmesser des Lichtleiters, so ist die Positionierung wie bei der Ausführungsform mit Fasernbündeln relativ unkritisch, auch wenn die Anpassung der Aperturen nicht so problemlos ist wie bei dem Fasernbündel.

Dieser Hohlspiegel eignet sich durchaus auch für die Kopplung von mehreren Lichtleitern. Dabei tritt dann eine rechts-links-Vertauschung auf, die jedoch problemlos bei der Verschaltung der elektro-optischen Wandler berücksichtigt werden kann.

Der Umlenkkoppler 22 bildet also die Koppelflächen 15 der Lichtleiter bevorzugt in eine Ebene parallel zu der Oberfläche der Leiterplatte ab. Der Abstand von der Ebene der Oberfläche wird durch die zu montierenden Bauelemente bestimmt und kann im Prinzip frei bestimmt werden. In Fig. 5 ist eine Montage eines elektro-optischen Wandlers 50 gezeigt. Dieser wird mit elektrischen Anschlüssen 51a, 51b an (nicht gezeigten) Leiterbahnen auf der Oberfläche 10a der Leiterplatte 10 bevorzugt durch Löten verbunden. In Fig. 5 ist diese Verbindung nur symbolisch dargestellt. Dabei ist die Position des Wandlers 50 in Bezug auf diese elektrischen Anschlußpunkte relativ unkrisch, da das Lot eine Verschiebung in der x-y-Ebene der Oberfläche 10a ausgleicht. Ferner wird der Wandler 50 an den Umlenkkoppler 20 optisch angeschlossen, wie es durch die Verbindung 52 stark symbolisiert ist. Diese besteht der Regel nur aus einem Kleb- und Füllstoff passenden op-

tischen Brechungsindexes; bevorzugt mündet der optische Koppler 53 in dem Wandler an der glatten Unterseite, die dann die Höhe des Wandlers vorgibt. Eine Bewegung des Koppelelements senkrecht zur Leiterplattenoberfläche ver-5 schiebt lediglich die Bilder der Koppelfläche in der Austrittsebene des Umlenkkopplers. Diese sind jedoch ohnehin nicht genau bestimmt, da die Tiefe der Lichtleiter in der Leiterplatte relativ schlecht reproduzierbar ist, bezogen auf den Durchmesser der Lichtleiter. Es ist also im Anschluß an das Einsetzen der Umlenkkoppler eine Positionsbestimmung in der Austrittsebene der Ummlenkkoppler notwendig. Hierzu werde angenommen, daß beide Enden eines Lichtleiters durch Koppler gemäß dieser Erfindung umgelenkt sind. Dann wird auf der einen Seite großflächig, d.h. auf die gesamte Austrittsebene des Kopplers, ein Lichtstrahl eingespeist, beispielsweise durch einen starken stationären Laser. Davon geht ein großer Teil der Lichtenergie verloren, da der Lichtleiter nur einen kleinen Teil der Eintrittsebene des Umlenkkopplers bedeckt. Auf der anderen Seite entsteht auf der Austrittsebene für jeden Lichtleiter ein scharf begrenzter Punkt. Dieser kann mit bekannten Verfahren, insbesondere durch CCD-Kameras, gegenüber anderen Fixpunkten sehr genau vermessen werden. Danach werden beide Seiten vertauscht und der Vorgang wiederholt. Mit den so gemessenen Positionen werden die Bauelemente, die in diesem Fall die elektrooptischen Wandler an der Unterseite haben, mit eine Präzisions-Positioniereinrichtung plaziert und befestigt.

20

15 '

11

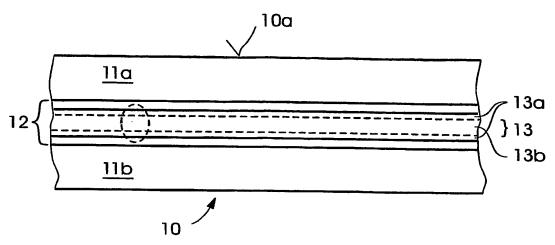
Patentansprüche

- Anordnung zur Kopplung an eine Koppelfläche (15) eines Lichtleiters (13), der sich im Innern einer Leiterplatte (10) befindet,
- dadurch gekennzeichnet,
 daß ein Umlenkkoppler (20) das Bild der Koppelfläche
 (15) in eine Ebene parallel zu der Oberfläche (10a)
 der Leiterplatte (10) abbildet.
- Anordnung nach Anspruch 1, wobei der Umlenkkoppler im
 wesentlichen aus einem als Fasernbündel ausgebildeten, gebogenen Bildleiter besteht.
 - 3. Anordnung nach Anspruch 2, wobei die wirksame Bildfläche des Umlenkkoppers um mindestens die mechanische Toleranzen bei der Einbettung der Lichtleiter größer als der Querschnitt derselben ist.
 - 4. Anordnung nach Anspruch 1, wobei der Umlenkkoppler einen Hohlspiegel umfaßt.
 - 5. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Koppelfläche senkrecht zu der Achse des Lichtleiters steht.
- 20 6. Verfahren zur Herstellung einer Kopplung an einen Lichtleiter, der sich im Innern einer Leiterplatte befindet, mit den Schritten:
 - Der Lichtleiter wird vollständig in die Leiterplatte eingebettet,
- in die Leiterplatte wird eine Öffnung eingebracht,
 die den Lichtleiter vollständig durchtrennt, so daß
 eine Austrittsfläche freigelegt wird,

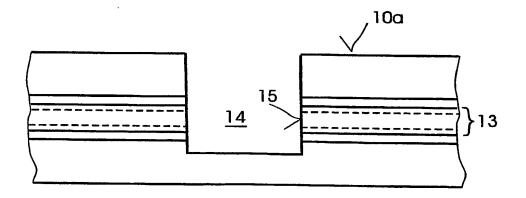
5

- in die Öffnung wird ein Umlenkkoppler mit zwei Bildflächen eingesetzt, so daß eine der Bildflächen auf die Austrittsfläche zu liegen kommt und die andere in oder über der Oberfläche der Leiterplatte liegt,
- der Umlenkkoppler wird in der Öffnung dauerhaft befestigt.

1/3

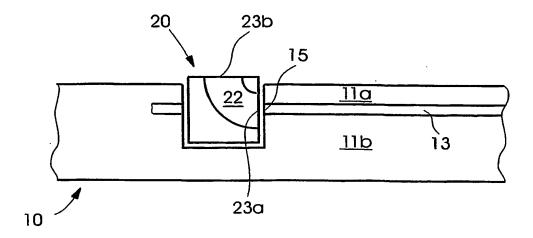


Figur 1

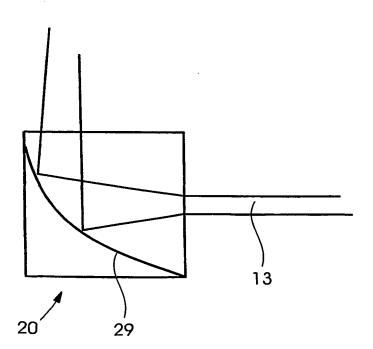


Figur 2

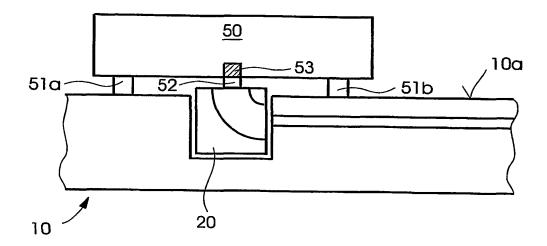
2/3



Figur 3



Figur 4



Figur 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

P E 00/03551

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G02B6/42 G02B6/26

G02B6/43

G02B6/06

G02B6/36

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{G02B} \end{array}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 362 961 A (HAMANAKA KENJIRO) 8 November 1994 (1994-11-08) column 10, line 32 - line 68 column 11, line 1 - line 68 column 12, line 1 - line 54 figures 11,12,16B,16D	1,5,6
X	US 5 277 930 A (UCHIDA TEIJI) 11 January 1994 (1994-01-11) figures 21,22 column 14, line 43 - line 68 column 15, line 1 - line 35	1,5,6

X Further documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in annex.
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
11 October 2001	18/10/2001
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Mathyssek, K

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

T/DE 00/03551 *

C (CAire	What Book and the second secon	7/DE 00/03551
Calegory °	cition) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	enament of document, which indication, where appropriate, or the relevant passages	nelevant to claim two.
E	US 6 257 771 B1 (OKAYASU TOSHIYUKI) 10 July 2001 (2001-07-10) figures 5,8-12 column 4, line 39 - line 67 column 5, line 1 - line 10 column 6, line 49 - line 67 column 7, line 1 - line 37	1,6
A	US 3 058 021 A (DUNN JOSEPH M) 9 October 1962 (1962-10-09) figure 4 column 6, line 16 - line 37	1,2
A	US 4 672 197 A (HORI TAKAMASA ET AL) 9 June 1987 (1987-06-09) the whole document	1,2,6
A	EP 0 807 981 A (FUJITSU LTD) 19 November 1997 (1997-11-19) column 23, line 13 - line 46 column 25, line 16 - line 49 figures 8,11,17	1,3-6

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

٠	ı		
٠,	٢		
,			

Patent document		Publication		Patent family	Publication
cited in search report		date		member(s)	date
US 5362961	Α	08-11-1994	JP	4131820 A	06-05-199
			JP	4131801 A	06-05-199
			JP	4130913 A	01-05-199
			JP	4177515 A	24-06-199
			JP	4175704 A	23-06-199
			JP	4270306 A	25-09-199
			JP	4270301 A	25-09-199
			JP	4275508 A	01-10-199
			US	5500523 A	19-03-199
			DE	69115815 D1	
			EP	0477036 A2	
			EP	0658786 A2	
			US 	5202567 A	13-04-199
US 5277930	Α	11-01-1994	JP	2857221 B2	
			JP	4011205 A	16-01-199
			JP	2857222 B2	
			JР	4011206 A	16-01-199
			DE	69110961 D1	
			DE	69110961 T2	
			EP	0454502 A1	
			JP	2042788 C	09-04-199
			JP	4027904 A	30-01-199
			JP	7066089 B	19-07-199
			US 	5195154 A	16-03-199
US 6257771	B1	10-07-2001	JP	10126018 A	15-05-199
			DE	19781160 TO	
			GB	2322479 A	
			WO	9818301 A1	30-04-199
US 3058021	Α	09-10-1962	NONE		
US 4672197	Α	09-06-1987	JP	61139720 A	27-06-198
·			DE	3573663 D1	
			EP	0187299 A	
EP 0807981	Α	19-11-1997	JP	9307134 A	28-11-19
			CN	1170284 A	14-01-199
			EP	0807981 A2	19-11-19
			US	5883988 A	16-03-199

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

T/DE 00/03551

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANNIELDUNGSGEGENSTANDES 1PK 7 G02B6/42 G02B6/26

G02B6/06 G02B6/43

G02B6/36

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK\ 7\ G02B$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

Kalegorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Х	US 5 362 961 A (HAMANAKA KENJIRO) 8. November 1994 (1994-11-08) Spalte 10, Zeile 32 - Zeile 68 Spalte 11, Zeile 1 - Zeile 68 Spalte 12, Zeile 1 - Zeile 54 Abbildungen 11,12,16B,16D	1,5,6	
X	US 5 277 930 A (UCHIDA TEIJI) 11. Januar 1994 (1994-01-11) Abbildungen 21,22 Spalte 14, Zeile 43 - Zeile 68 Spalte 15, Zeile 1 - Zeile 35/	1,5,6	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	χ Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
11. Oktober 2001	18/10/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Mathyssek, K

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

FEDE 00/03551

		DE 00/03331
	ung) ALS WESENTLICH GESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	menden Teile Betr. Anspruch Nr.
E	US 6 257 771 B1 (OKAYASU TOSHIYUKI) 10. Juli 2001 (2001-07-10) Abbildungen 5,8-12 Spalte 4, Zeile 39 - Zeile 67 Spalte 5, Zeile 1 - Zeile 10 Spalte 6, Zeile 49 - Zeile 67 Spalte 7, Zeile 1 - Zeile 37	1,6
A	US 3 058 021 A (DUNN JOSEPH M) 9. Oktober 1962 (1962-10-09) Abbildung 4 Spalte 6, Zeile 16 - Zeile 37	. 1,2
А	US 4 672 197 A (HORI TAKAMASA ET AL) 9. Juni 1987 (1987-06-09) das ganze Dokument	1,2,6
A	EP 0 807 981 A (FUJITSU LTD) 19. November 1997 (1997-11-19) Spalte 23, Zeile 13 - Zeile 46 Spalte 25, Zeile 16 - Zeile 49 Abbildungen 8,11,17	1,3-6

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

T/DE 00/03551 '

			1/DE 00/03551		
Im Recherchenberich ngeführtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5362961	А	08-11-1994	JP JP JP JP JP JP US DE EP EP	4131820 A 4131801 A 4130913 A 4177515 A 4175704 A 4270306 A 4270301 A 4275508 A 5500523 A 69115815 D1 0477036 A2 0658786 A2 5202567 A	06-05-1992 06-05-1992 01-05-1992 24-06-1992 23-06-1992 25-09-1992 25-09-1992 01-10-1992 19-03-1996 08-02-1996 25-03-1992 21-06-1995 13-04-1993
US 5277930	A	11-01-1994	JP JP JP DE DE DE EP JP JP JP	2857221 B2 4011205 A 2857222 B2 4011206 A 69110961 D1 69110961 T2 0454502 A1 2042788 C 4027904 A 7066089 B 5195154 A	17-02-1999 16-01-1992 17-02-1999 16-01-1992 10-08-1995 21-12-1995 30-10-1991 09-04-1996 30-01-1992 19-07-1995 16-03-1993
US 6257771	B1	10-07-2001	JP DE GB WO	10126018 A 19781160 TO 2322479 A ,B 9818301 A1	15-05-1998 28-01-1999 26-08-1998 30-04-1998
US 3058021	A	09-10-1962	KEINE		
US 4672197	A	09-06-1987	JP DE EP	61139720 A 3573663 D1 0187299 A1	27-06-1986 16-11-1989 16-07-1986
EP 0807981	Α	19–11–1997	JP CN EP US	9307134 A 1170284 A 0807981 A2 5883988 A	28-11-1997 14-01-1998 19-11-1997 16-03-1999

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)